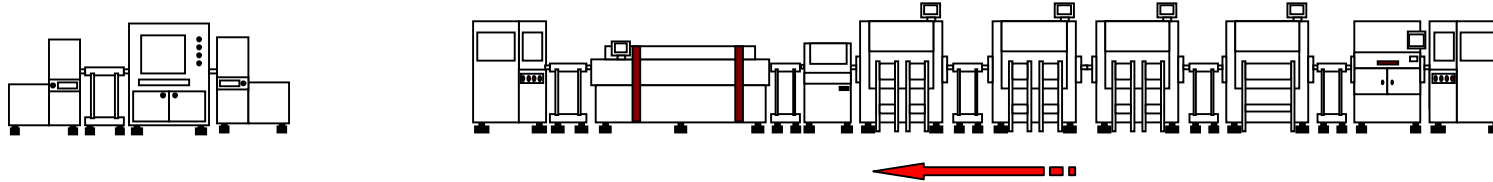


## PROCESS D'ASSEMBLAGE AUTOMATIQUE

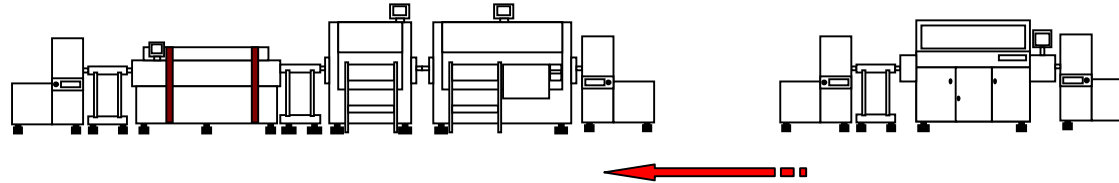
**LIGNE REFUSION 1 : Machines SP28 & Topaz & Topaz X fnc & Topaz X II sf & Emerald X II sf & four Vitronics Soltec**



### Spécifications générales de la ligne

Cadence :	Théorique : 38 000 cps/h
Gamme de composants :	Chips 0201 ( 0.6 x 0.3 mm ) à boîtier de 45 x 45 mm au pas de 0.5 mm QFP de 45 x 45 mm maxi au pas de 0.5 mm mini QFP de 31 x 31 mm maxi au pas de 0.4 mm mini QFP de 20 x 20 mm maxi au pas de 0.3 mm mini BGA de 45 x 45 mm maxi au pas de 0.5 mm mini Connecteur de 100 mm de long maxi au pas de 1.27 mm mini Hauteur Maxi des composants 20 mm
Format des PCB :	Dimensions 460 x 360 mm ( sans tenir compte de la machine Topaz 457 x 300 mm ) Epaisseur 0.5 à 3 mm maxi
Four de refusion :	Four QUANTIS PRO 8 zones compatible au sans plomb
Machine AOI :	Machine de vision OMRON VT-RNS

## LIGNE REFUSION 2 : Machines SPP-A & Sapphire & Emerald & four Panasonic

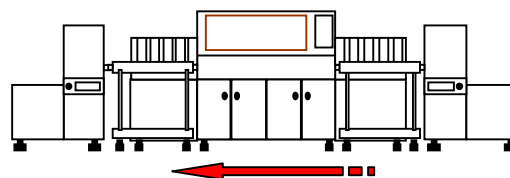


### Spécifications générales de la ligne

Cadence :	Théorique : 21 000 cps/h
Gamme de composants :	Chips 0603 ( 1.6 x 0.8 mm ) à boîtier de 54 x 54 mm QFP de 54 x 54 mm maxi au pas de 0.5 mm mini ( sous conditions spéciales ) QFP de 32 x 32 mm maxi au pas de 0.3 mm mini BGA de 54 x 54 mm maxi au pas de 1.27 mm mini BGA de 32 x 32 mm maxi au pas de 0.8 mm mini Hauteur Maxi des composants 15 mm
Format des PCB :	Dimensions 330 x 250 mm Epaisseur 0.6 à 3 mm maxi
Four de refusion :	Four PANASONIC REF-A 3 zones (uniquement sans plomb)

## PROCESS D'ASSEMBLAGE AUTOMATIQUE

### PROCESS AXIALE : Machine AVK2

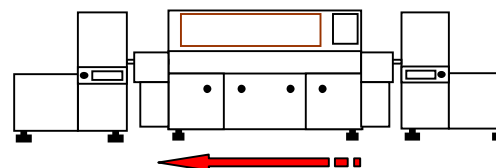


#### Spécifications générales de la ligne

Cadence :	Théorique : 24 000 cps/h
Gamme de composants :	Pas d'insertion de 5 mm à 12.7 mm pour composants en bande ammpack de 26 mm & 5 mm à 26 mm pour bande de 52 mm Diamètre de corps des composants de 4.4 mm maxi ; Diamètre de patte de 0.4 à 0.8 mm Diamètre des Strap en bobine de 0.6 mm pour pas d'insertion entre 5 mm et 26 mm
Format des PCB :	Dimensions 508 x 381 mm ; Epaisseur de 1.6 à 2 mm ; Positionnement par pion d'indexage
Type de chargeurs :	Feeder de 26 mm & 52 mm ; Bobine de strap de 10 kg

\*\*\*\*\*

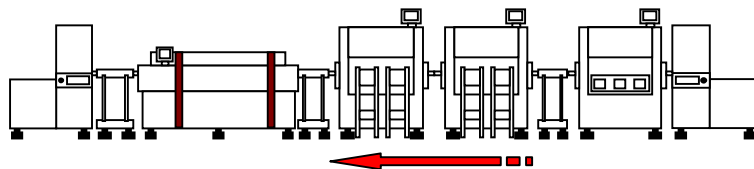
### PROCESS RADIALE : Machine RHS2B



#### Spécifications générales de la ligne

Cadence :	Théorique : 21 000 cps/h
Gamme de composants :	Pas d'insertion de 2.5 mm ou 5 mm ( composants 2 ou 3 pattes ) Diamètre de corps des composants de 12 mm maxi ; Diamètre de patte de 0.4 à 0.65 mm Hauteur de corps des composants de 22.5 mm maxi
Format des PCB :	Dimensions 508 x 381 mm ; Epaisseur de 1.6 à 2 mm ; Positionnement par pion d'indexage
Type de chargeurs :	Feeder pour composants en boîte ammpack ( P=12.7mm ) ou rouleaux ( P=12.7 mm )

## LIGNE POLYMERISATION : Machines HSDX & Topaz X fnc & Topaz X sf & four Panasonic UV



### Spécifications générales de la ligne

Cadence :	Théorique : 24 000 cps/h
Gamme de composants :	Chips 0603 ( possibilité de pose de chips 0402 ) à boîtier de 32 x 32 mm au pas de 0.5 mm QFP de 32 x 32 mm maxi au pas de 0.5 mm mini Hauteur Maxi des composants 4 mm
Format des PCB :	Dimensions 460 x 440 mm Epaisseur 0.4 à 4 mm maxi
Type de chargeurs :	Feeder de 8 mm \ 12 mm \ 16 mm \ 24 mm \ 32 mm \ 44 mm plateau manuel ( commun à l'ensemble des lignes de placement ) pour composants divers
Four de polymérisation :	Four PANASONIC UV

### Conditions Générales

Magasins de stockage : Petite taille pour PCB de 250 mm Maxi de largeur ; Grande taille pour PCB de 318 mm Maxi de largeur  
En fonction du poids et de la forme des composants il peut être nécessaire de développer des buses de préhensions spéciales